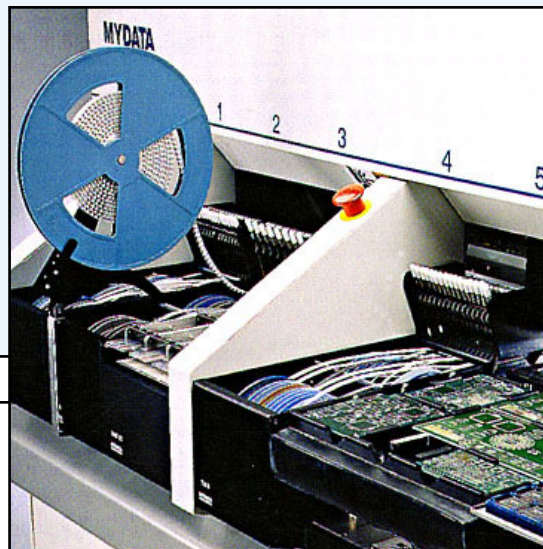


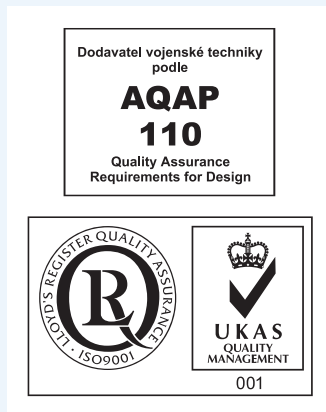
Osazování součástek SMD

Očištění desky plošných spojů před osazováním součástek, automatické nanášení pájecí pasty sítotiskem nebo použitím ručního dispenseru (jenom vzorky), jedno nebo oboustranné osazování součástek na automatickém nebo poloautomatickém osazovacím stroji, v infračervené přetavovací peci s konvenční podporou, očištění DPS po pájení v mycím zařízení s ultrazvukem, 100 % optická kontrola všech DPS, možný elektrický test.

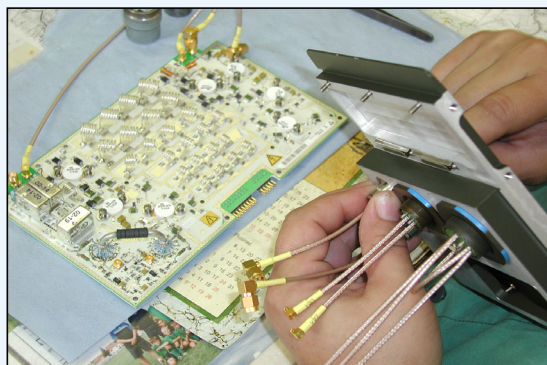
Vizuální systém oprav pro součástky s roztečí vývodů do 0,3 mm.



Automatické osazování	
max. rozměry DPS: rozměry součástky:	300 x 200 mm min. 0402, max. QFP, BGA s roztečí 0,3 mm
kapacita: možná elektronická kontrola součástek R, C, D, T vyžadované výrobní podklady:	60 000 součástek/den filmy pro výrobní síta nebo planžety (rámy specifikujeme) data pro osazování v CAD (Protel 3,6) osazovací
Poloautomatické osazování	
max. rozměr DPS: rozměry součástek: kapacita: vyžadované výrobní podklady:	300 x 200 mm 0603 do PLCC84. 4 000 součástek/den pro sériovou výrobu: filmy pro síta nebo planžety (rámy specifikujeme) data pro osazování v CAD osazovací výkresy a kusovníky, BOM technologické díry na DPS pro upnutí ve stroji (ø 3)
Standardní dodací podmínky	
sériová výroba: vzorky a prototypy:	2 týdny do 3 dnů



Osazování vývodových součástek



Technologický postup:

Očištění DPS před osazováním součástkami, ruční osazování vývodových součástek, pájení vlnou nebo ručně, očištění DPS po pájení v mycím zařízení s ultrazvukem, 100% optická kontrola všech DPS, možný elektrický test.

max. rozměry DPS: kapacita: vyžadované výrobní podklady:	300 x 200 mm 100 ks PCBs (4 000 součástek) výkres, BOM, technologické díry na DPS pro upnutí ve stroji (ø 3)
---	---

Montáž elektronických zařízení

SMT a smíšená technologie osazování součástek jedno nebo oboustranně, výroba kabelů, montáž elektronických podsestav včetně konečného měření, zahořování (rozmezí teploty -60 °C až 85 °C), výstupní kontrola.

DICOM, spol. s r. o.,
firma s tradicí vývoje a výroby letecké a speciální
elektroniky a zajištěním systémem kvality,
rozšiřuje nabídku kooperačních služeb zákazníkům.



Kontaktní osoba: Miroslav Vlčnovský, referent OBO, E-mail: miroslav.vlcnovsky@dicom.mesit.cz
Tel.: 572 522 491, 572 801 491, Fax: 572 522 836, 572 801 836

DICOM, spol. s r. o., Sokolovská 573, P. O. Box 129, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika